

SP-1500R



・特徴

成膜室は小型ですが、基材加熱温度も高く、RF モードのスputタリングが出来ますので、基材の大きさが 3 インチ以下であれば、高度な成膜実験が出来ます。圧力調整弁は手動式ですが、マスフローコントローラによるガス流量調整によって、高精度圧力調整が出来ます。

・仕様

到達圧力	$\times 10^{-4}$ Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	$\times 10^{-4}$ Pa 台迄 20 分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	$\phi 300\text{mm} \times 250\text{mmH}$ SUS304 電解研磨
スパッタ用電源	RF 電源 13.56MHz 500W 手動マッチング 1 台
基板形状	$\phi 50\text{mm}$ 1 枚
膜厚分布	$\pm 15\%$ 以内
ターゲット寸法	3 インチ(金属・絶縁物)
ターゲット個数	1
基板回転	有り
基板加熱	常温 $\sim 500^{\circ}\text{C}$ 迄昇温可能
真空排気系	油回転ポンプ：350L/min 油拡散ポンプ：600L/sec
操作方法	手動
ガス系統	マスフローコントローラ 1 系統
ユーティリティ	電気：AC200V 三相 7KVA 冷却水：7L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25°C 以下循環 計装エア：0.5MPa 以上 設置寸法：1200mmW \times 1000mmD \times 1600mmH